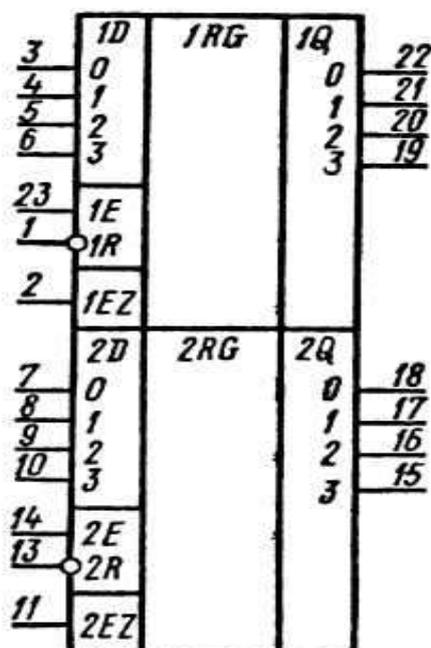


КР1533ИР34, КФ1533ИР34, ЭКФ1533ИР34

Микросхемы представляют собой два четырехразрядных буферных регистра с тремя устойчивыми состояниями на выходе. Корпус типа 2142.24-2, масса не более 4 г и 4322.24-А.

Назначение выводов: 1 - вход установки с состояние «низкого уровня» $\overline{1R}$; 2 - вход разрешения состояния высокого импеданса 1EZ; 3 - вход информационный 1D0; 4 - вход информационный 1D1; 5 - вход информационный 1D2; 6 - вход информационный 1D3; 7 - вход информационный 2D0; 8 - вход информационный 2D1; 9 - вход информационный 2D2; 10 - вход информационный 2D3; 11 — вход разрешения состояния высокого импеданса 2EZ; 12 - общий; 13 - вход установки в состояние «низкого уровня» $\overline{2R}$; 14 - вход разрешения 2E; 15 - информационный выход 2Q3; 16 - информационный выход 2Q2; 17 - информационный выход 2Q1; 18 - информационный выход 2Q0; 19 - информационный выход 1Q3; 20 - информационный выход 1Q2; 21 - информационный выход 1Q1; 22 - информационный выход 1Q0; 23 - вход разрешения 1E; 24 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР34, КФ1533ИР34, ЭКФ1533ИР34

Таблица истинности

Вход				Выход
\bar{R}	D	E	EZ	Q
X	X	X	1	Z
0	X	X	0	0
1	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	X	0	0	Q0

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Ток потреблений при высоком уровне выходного напряжения, при $U_n = 5,5$ В	≤ 21 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, при $U_n = 5,5$ В	≤ 29 мА
Ток потребления в состоянии «выключено» при $U_n = 5,5$ В	≤ 31 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -0,2 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- по входу разрешения	≤ 26 нс
- по информационному входу	≤ 20 нс
- по входу установки в состояние низкого уровня	≤ 28 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- по входу разрешения	≤ 33 нс
- по информационному входу	≤ 20 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния «выключено» в состояние высокого (низкого) уровня	≤ 15 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ
Емкость выхода	≤ 7 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.